

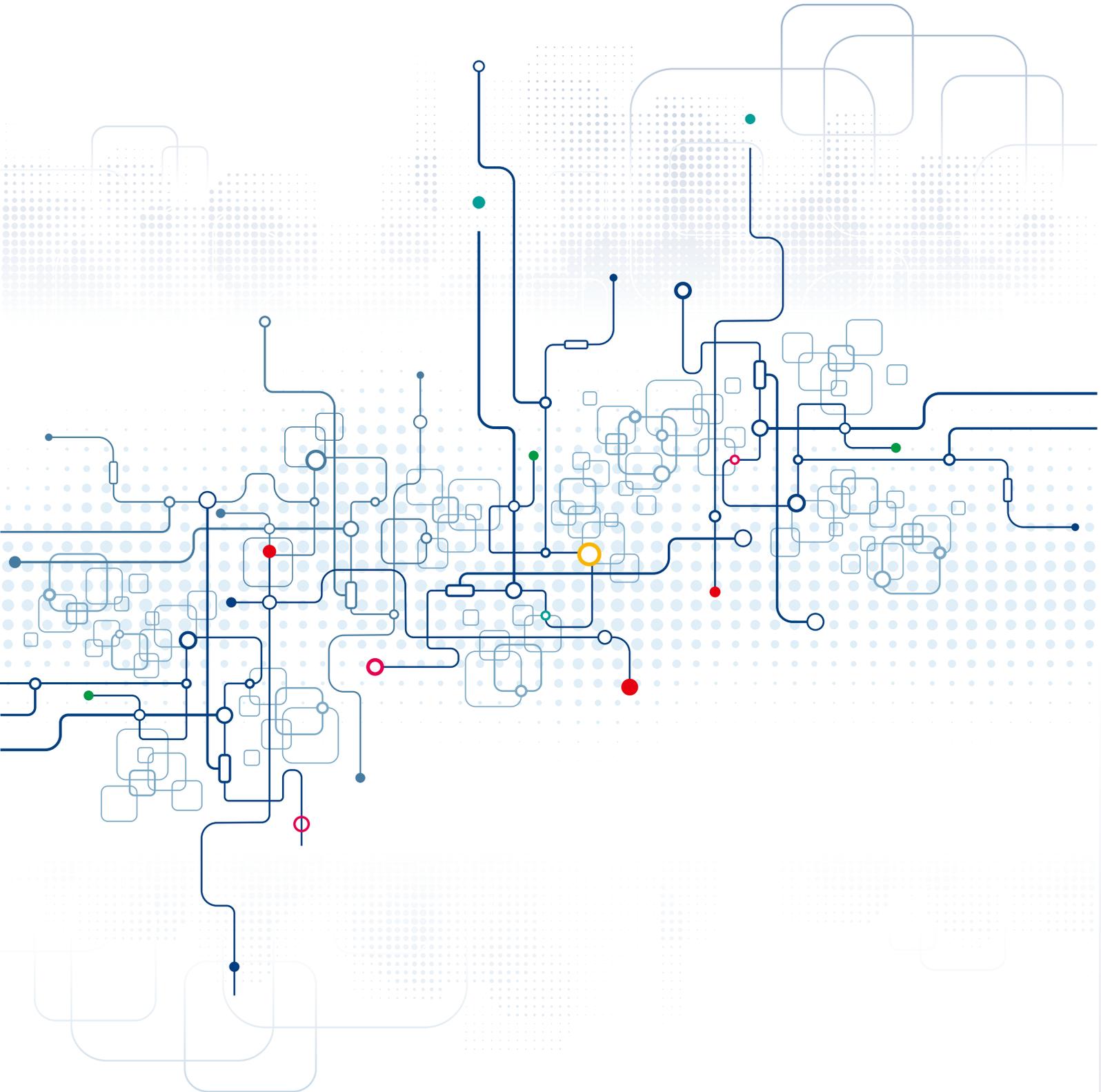
Tera Probe

株式会社テラプローブ

第9期 株主通信

2013年4月1日～2014年3月31日

- ごあいさつ
- 連結決算ハイライト
- TOPICS
- 特集(Q&A)
- NEWS
- 会社情報／株式情報





みなさまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2013年度の当社グループが属する半導体市場は、PC向けやデジタル家電向け製品は低調でしたが、モバイル機器向けや車載向け製品は年間を通して好調に推移したため、市場全体は順調に拡大いたしました。

当社グループの業績は、メモリ事業におきましては、マイクロンメモリ ジャパン株式会社(旧社名エルピーダメモリ株式会社)を筆頭に国内と台湾でモバイル向け製品の受託が安定して推移し、ゲーム向け製品や半導体ユーザー企業(セットメーカー)からの受託も順調に増加いたしました。システムLSI事業におきましては、テスト受託が国内、台湾とも順調に増加いたしました。このような状況の中、売上高は前年度から1.7%増の21,668百万円、営業利益は前年度の営業損失から837百万円へ大幅に改善し、経常利益は783百万円となりました。当期純利益につきましては、固定資産の減損等の特別損失の計上などから61百万円となりました。なお、配当金につきましては、繰越利益剰余金が欠損の状況であることから、誠に遺憾ながら無配とさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

当社では、既存事業の収益改善と共に新たなビジネスの育成にも力を入れております。その一環として2014年2月に社長直轄の組織、先行技術開発室を新設いたしました。当開発室ではNEC製顔認証エンジン「NeoFace(ネオフェイス)」の画像処理技術を応用した組み込みソフトウェア開発、生体信号を用いたヒューマンインターフェース技術の研究などを行っております。2014年5月には第17回組み込みシステム開発技術展に、ARMベースのマイコンに当社が開発いたしました顔認証ソフトウェア、「TeraFaces(テラフェイスズ)」を組み込み、このマイコンを搭載した試作機を参考出展いたしましたところ、多くのお問い合わせをいただきました。来年度からの収益化に向けて、さらに開発を加速してまいります。

今後も既存の事業に加え、新たなビジネスにも挑戦し、企業価値の向上を図ってまいります。

株主のみなさまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 兼 CEO

渡辺 雄一郎



連結決算ハイライト

メモリ事業について

メモリ事業におきましては、テスト時間の短縮は間断なく継続しているものの、主にモバイル機器に使用されるテスト時間の長い製品の受託数量が順調に推移したことに加え、ゲーム向けメモリ製品の受託数量が増加いたしました。また、半導体ユーザーであるセットメーカーからのテスト受託数量も順調に増加し、メモリ事業は全般に堅調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は16,032百万円(前年同期比5.1%増)、セグメント利益は2,908百万円(同55.6%増)となりました。

システムLSI事業について

システムLSI事業のテスト受託におきましては、国内、台湾ともに新規受託の獲得により順調に増加いたしました。しかしながら、ウエハレベルパッケージ(WLP)・BUMP受託では、既存製品の成熟化に対し、新規受託品の拡大が遅れたことなどから低調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のシステムLSI事業の売上高は5,646百万円(前年同期比6.9%減)、セグメント損益は818百万円の損失(前年同期は496百万円の損失)となりました。

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	2013年3月末	2014年3月末
(資産の部)		
流動資産合計	11,022	13,820
固定資産合計	24,519	19,693
資産合計	35,542	33,514
(負債の部)		
流動負債合計	7,760	7,686
固定負債合計	5,544	3,156
負債合計	13,304	10,842
(純資産の部)		
資本金	11,823	11,823
資本剰余金	11,380	11,380
株主資本合計	20,145	20,206
純資産合計	22,237	22,671
負債純資産合計	35,542	33,514

POINT リース債務の返済が進み、財務体質が強固に

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	2012年度	2013年度
	(2012年4月1日～2013年3月31日)	(2013年4月1日～2014年3月31日)
売上高	21,306	21,668
売上原価	19,119	18,732
売上総利益	2,187	2,935
販売費及び一般管理費	2,229	2,098
営業利益	△42	837
営業外収益合計	577	174
営業外費用合計	434	229
経常利益	101	783
特別利益合計	260	489
特別損失合計	4	960
税金等調整前当期純利益	357	312
法人税等	△221	18
少数株主利益	78	232
当期純利益	500	61

POINT 売上高は前年比で横ばいだが、営業利益が大幅に改善

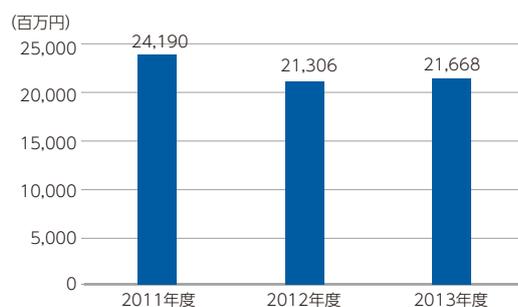
連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

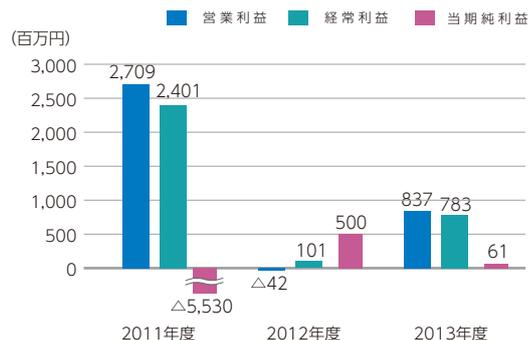
科目	2012年度	2013年度
	(2012年4月1日～2013年3月31日)	(2013年4月1日～2014年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,543	8,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,896	△3,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,260	△2,757
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	485	1,839
現金及び現金同等物の期末残高	6,043	7,882

POINT 営業活動によるキャッシュ・フローが改善

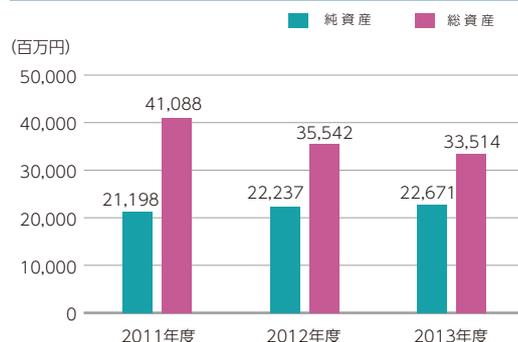
売上高



営業利益・経常利益・当期純利益



純資産・総資産





展示会への出展

テラプローブは国内外の様々な展示会に積極的に出展しています。ウエハレベルパッケージ(WLP)製品サンプルや説明パネルを配したブースでは、説明員が来場者のご質問に一つ一つお答えし、提供サービスと新技術の紹介を行っております。

今期は当社としては初めて、上海で開催されたセミコン・チャイナ2014に参加、さらに2014年5月には、組込みシステム開発技術展にも出展いたしました。今後も、出展の機会を最大限活用して当社の優位性をアピールし、新規顧客獲得による事業拡大を目指してまいります。

◆ 2013年12月4日～6日

セミコン・ジャパン2013(幕張メッセ)

世界最大級の半導体製造装置・材料の総合展示会です。幕張メッセでの開催は今回が最後になりました。当社ブースでは、WLP化DRAMを搭載したPCデモ機やインクジェット方式で加工したWLP用ウエハなどを展示し、3日間の開催期間中、大勢の来訪者で賑わいました。



◆ 2014年1月15日～17日

第15回半導体パッケージング技術展(東京ビッグサイト)

半導体、LED、パワーデバイス、MEMSデバイスなどに必要な装置、部品・材料、サービスが一堂に会する、パッケージング技術に特化した専門技術展です。

当社のパッケージ技術であるWLPの特徴を主に紹介しています。



◆ 2014年3月15日～18日

セミコン・チャイナ2014(Shanghai New International Expo Center)

上海にある巨大な展示場で開催され、セミコン・ジャパンを上回る出展社数で、会場とその周辺は大変賑わっていました。初の出展となった当社のブースには、まだ馴染みのないWLPに興味を持った方々が訪れました。中国市場の動向を知るうえで、当社にとっても貴重な経験になりました。



◆ 2014年5月14日～16日

第17回組込みシステム開発技術展(東京ビッグサイト)

当展示会には初出展となりますが、当社が新たに開発した顔認証システムを搭載した、家庭用ロボットのデモ機を展示いたしました。来訪者ご自身に顔認証を体験していただき、高評価をいただきました。



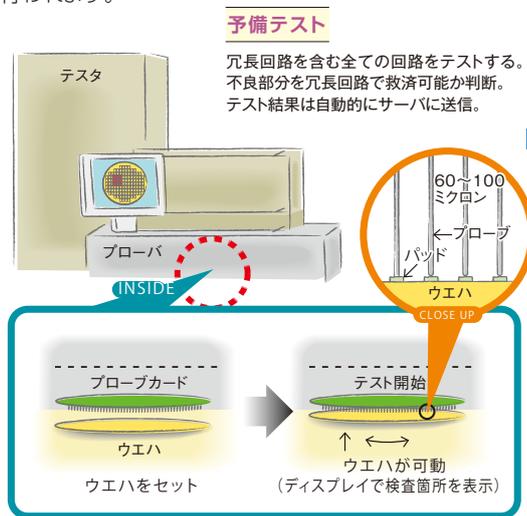


ウエハテストは何をしているの？

DRAMを例にご説明いたします。

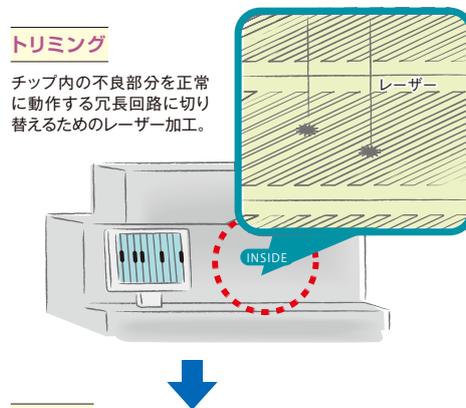
半導体製造工程におけるテスト工程は、ウエハテスト工程と、ファイナルテスト工程の二つがあります。

このうち、ウエハ状態で行うテスト工程が、当社が行っているウエハテスト工程です。ウエハテスト工程は、ウエハをテスト位置まで搬送してミクロン単位で正確に移動させるプローバという装置、テストプログラムによって設計どおりに動作するかどうかを確認するテスト、ウエハ上の全てのICチップの電極に探針(プローブ)を当て、ウエハとテストを接続する役目のプローブカード。以上の三つの機器を使用して行われます。



ウエハテスト工程では本テストの前に、予備テストを行います。予備テストでは、不良判定されたチップが冗長回路(予備回路)に置換可能か判断し、置換可能な回路は、次のトリミング工程でレーザーを照射し、正常に動作する冗長回路に切り替えられます。

その後、本テストを行い、良品チップと不良チップに最終判定されます。微細化により、ウエハ上のチップ数が増加するとテストコストも上昇しますが、これらのテスト工程、トリミング工程を高効率に行うことで、顧客のテストコスト低減に貢献しています。



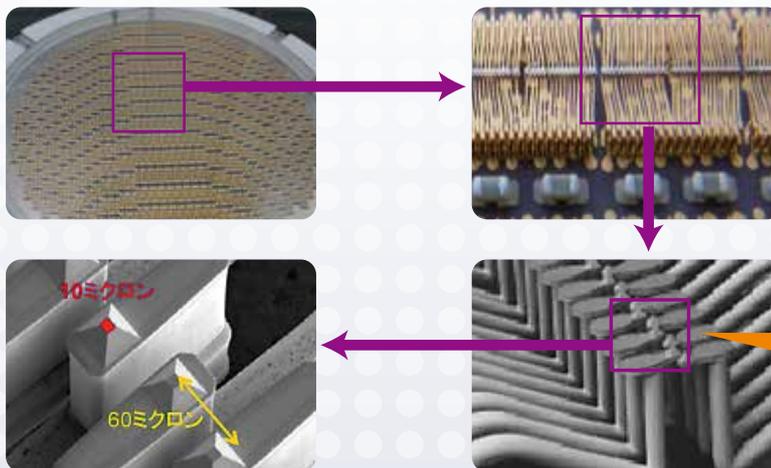
本テスト
予備テストと同じ作業を再度行い、全てのチップをテストして、良品か不良品かを判断。テスト結果は自動的にサーバに送信。サーバに蓄積したデータを顧客へ送信。



プローブカードとは？

プローブ(探針)カード(基板)=[探針を配置した基板]という意味です。探針の先端は10ミクロン(=1000分の10mm)ほどで、髪の毛の太さの約10分の1くらいです。

検査対象となるICチップの品種ごとに、専用プローブカードを用意いたします。

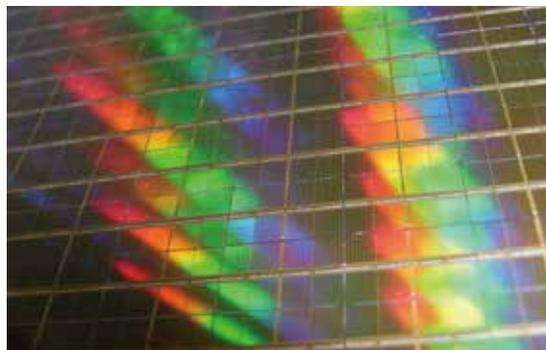




テラプローブの強みとは？

当社は半導体メーカーのテスト部門が独立してできた会社です。テスト工程を通じて半導体の開発・生産に携わり、テストプログラム開発からプローブカード設計、高効率なオペレーションなど、半導体テスト全般に豊富な経験を有していることが最大の強みです。

また、国内最大規模のテスト装置を揃え、国内外の顧客からの様々なご要望に対し、最適なテスト条件を提案してテストを行っています。



DRAMの市場価格がテラプローブの業績に与える影響は？

DRAM市場価格はDRAMメーカーの利益には直結しますが、価格が急激に変化しても、当社の売上にただちに影響を与えることはありません。

言い換えるならば、市場価格に左右されないということは、リスク回避の面ではメリットですが、市況が好調でも業績

は変化がないということでもあります。

当社にとりましては、顧客からのウエハ支給枚数が増えたり、テスト項目が増えてテスト時間が長くなることによってテストの稼働率が上昇することが収益アップに繋がる条件になります。



テラプローブの成長戦略は？

半導体業界においては、国内では閉塞感が高まっていますが、世界に目を向けると、引き続き成長を続けており、それらの生産の中心は台湾となっています。当社は子会社のテラパワー（台湾名：晶兆成科技）を台湾の拠点として、成長する市場でビジネスチャンスを狙います。

一方で国内では、主軸であるテストとパッケージの受託に加え、新規事業である顔認証システムなどのソフトウェアの開発、生体信号を用いた機器操作の研究にも取り組んでおり、さらなる企業価値の向上を図ります。



テラパワー（晶兆成科技）社屋



○ テラプローブはON Semiconductor社の 栄えある2013 Supplier Quality Awardを 受賞いたしました

2014年3月25日にON Semiconductor社の群馬工場において『Annual Perfect Quality Award 2013』の表彰が行われました。

『Annual Perfect Quality Award 2013』はON Semiconductor社が年間を通して優秀な品質によりビジネスに貢献した委託先を表彰するプログラムで、この度、材料及びアウトソーシング先300社以上の中からテラプローブがAnnual Perfect Quality Awardに選定されました。

年間を通し、規定取引量以上を維持し、品質トラブルが無く、品質評価項目が満点であったことで受賞となりました。また、Foundryカテゴリでは、2013年はテラプローブ1社のみを受賞となりました。

テラプローブはこれからもお客様に信頼されるベストパートナーを目指し、より高い目標に向かって、高品質なサービスを提供してまいります。



○ 新たな技術領域へのチャレンジ

テラプローブは要素技術の研究・開発を行う専門の研究開発部門として、先行技術開発室を立ち上げました。先行技術開発室は、半導体を使用した製品の付加価値をさらに高める提案を行います。

その提案の第一弾が顔認証ソフトウェアライブラリ、「TeraFaces(テラフェイスズ)」です。「TeraFaces」はPC不要で、マイコンによる世界最高クラスの顔認証率を実現いたしました。

当社の「TeraFaces」の応用分野としては、セキュリティ分野だけでなく、医療/介護分野、店舗等でのカスタマーサービス、コミュニケーション・ロボットなどがあり、私たちの暮らしを豊かにする新たなコミュニケーションを実現いたします。



注:ロボットは展示用に用意した市販品であり、当社の製品ではございません。

特徴

◆PCベースで開発されたNEC社製顔認証エンジン(NeoFace®)を、性能劣化なく組み向けとして再構築。アルゴリズムの完全継承に成功し、組み込み分野においても高性能を実現いたしました。

※「NeoFace」は日本電気株式会社の登録商標です。

◆高度な組み込みソフトウェア技術により、高速処理を実現し、ストレスなく顔認証処理を実行可能です。

想定される用途例

- ドアホン
- 防犯用監視カメラ
- 介護医療用ロボット
- コミュニケーション・ロボット
- カーナビゲーション装置
- アルコールインターロック...など

会社情報 / 株式情報

会社概要

2014年3月31日現在

社名	株式会社テラプローブ (英文:Tera Probe, Inc.)
設立	2005年8月
資本金	11,823百万円
従業員	433名(単体)、600名(連結)
事業内容	メモリ事業 DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、テストプログラム開発、WLP・Bumpの受託 システムLSI事業 SoC、イメージセンサ、マイコン等 各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト、テストプログラム開発、WLP・Bumpの受託

役員 の 状 況

2014年6月24日現在

代表取締役社長	わたなべ ゆういちろう 渡辺 雄一郎	常勤監査役	ましこ たかゆき 増子 尚之
代表取締役副社長	こだいら ひろんど 小平 広人	監査役	ひがき おさむ 檜垣 修
取締役	よこやま つよし 横山 毅	監査役	うちこし ゆうすけ 打越 佑介
社外取締役	はぎわら としあき 萩原 俊明		
社外取締役	ふくだ たけひろ 福田 岳弘		
社外取締役	もりもと けんじ 森本 賢治		

株 式 情 報

2014年3月31日現在

発行可能株式総数	30,000,000 株
発行済株式総数	9,282,500 株
株主数	2,218 名

大 株 主

2014年3月31日現在

株主名	持株数	(%)
マイクロメモリジャパン株式会社	3,680,000	39.64
MSIP CLIENT SECURITIES	1,080,100	11.63
株式会社アドバンテスト	760,000	8.18
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	578,900	6.23
UBS AG HONG KONG	305,800	3.29
株式会社SBI証券	207,100	2.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	158,200	1.70
神林忠弘	120,100	1.29
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY(CAYMAN) LIMITED	98,000	1.05
日本証券金融株式会社	88,200	0.95

株 主 メ モ

上場証券取引所	東京証券取引所 マザーズ
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位	100株
公告方法	公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL	http://www.teraprobe.com/
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	☎0120-782-031
ホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency

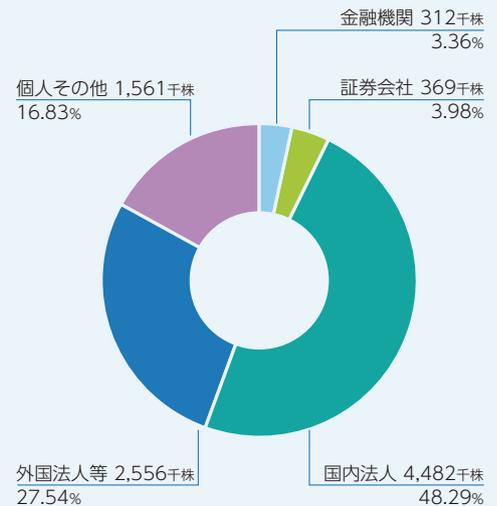
株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17
TEL:045-476-5711
ホームページURL http://www.teraprobe.com/

事業拠点



所有者別分布状況 (2014年3月31日現在)



ホームページのご案内

当社では、株主・投資家のみなさまにプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページで公開しております。是非、ご覧ください。



本誌は、FSC®認証紙と、植物性インキを使用しています。